ELECTRICAL CHARACTERISTIC MEASURING INSTRUMENT

Patent number:

JP1072079

Publication date:

1989-03-16

Inventor:

HAYAKAWA TOMOJI; others: 01

Applicant:

TOKYO ELECTRON LTD

Classification:

- international:

G01R31/00; H01L21/66

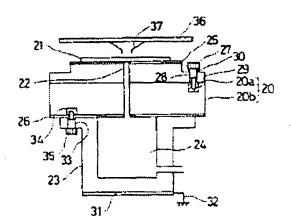
- european:

Application number: JP19880153742 19880622

Priority number(s):

Abstract of JP1072079

PURPOSE:To measure the electrical characteristic of an object to be measured with high accuracy by constituting the placing board of the object to be measured of an insulator. CONSTITUTION:In case of measuring the electrical characteristic of the object to be measured by a micro current, since large insulation resistance is attached on the placing board 20 by constituting the placing board 20 of an upper part 20a made of quartz and a lower part 20b made of ceramic, it is possible to prevent the placing board 20 from being affected by a neighboring motor or a noise from the outside. As a result, it is possible to prevent an eddy current due to the noise from being generated, thereby, to improve the measuring accuracy of the electrical characteristic of the object to be measured. Also, even in case of measuring the electrical characteristic of the object to be measured by using a large current, since the placing board 20 is constituted of the insulator having the large electrical insulation resistance, it is possible to prevent discharge between a shielding member 31 and a semiconductor wafer 21 on which a high voltage is impressed from being generated, and to measure the electrical characteristic of the object to be measured with extremely high accuracy.



文献 1

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出頭公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-72079

@Int_Cl.4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和64年(1989)3月16日

G 01 R 31/00 H 01 L 21/66

6829-2G B-6851-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全11頁)

9発明の名称 質

電気特性測定装置

玔

田

②特 願 昭63-153742

學出 顏 昭63(1988)6月22日

優先権主張

砂昭62(1987) 6月24日9日本(JP)到特願 昭62−157430

砂発 明 者

友 司

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 東京エレクトロン株

式会社内

砂発明者 内

拓 男

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 東京エレクトロン株

式会社内

切出 顋 人

東京エレクトロン株式

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

会社

明 和 书

1. 発明の名称

包负特性测定装置

2. 特許請求の範囲

被測定体を導電性薄板を介して穀屋台に穀屋し、この被測定体の電気的特性を測定する装置において、上記穀屋台を絶録体により構成することを特徴とする電気特性測定装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

この発明は、駄気特性測定装置に関する。

(従来の技術)

例えば、多数個の半導体チップを形成した半導体ウエハは、検査工程で半導体チップの世気的特性の測定が行われる。

このような電気特性測定装配として、従来、例えば第8回に示すような半導体ウエハプローパが使用されている。図中①は、被測定体の半導体ウエハである。半導体ウエハ(1)には、多数個の半導

体チップが規則正しく形成されている。上記半導 体ウエハ(1)は、収置台図上に載置されている。収 置台口は、セラミック台(語)上にアルミニウム台 (2b)を稜層した構造になっている。 報酲台図の上 方には、半導体ウェハ(1)に対向するようにしてプ ローブカード口が配置されている。プローブカー ド切には、プローブ針のが突起されている。半導 体チップの包気特性の測定は、プローブ針(2)を所 定の半導体チップのパッド部(チップ内の電極) に当接して行う。すなわち、プローブ針(1)と半線 体チップとを世気的に再通した状態にする。次い で、テスタに接続されたプローブ針似何から半導 体チップ側に測定付号を供給し、半導体チップか らの検査信号を検出する。このときの検査信号と 予め定められた特性値と比較し電気的特性を離べ る・この場合、セラミック台(34)の下面に取付け たシールド板口によって、叙収台四は外部ノイズ から電気的遮断されている。すなわち、シールド 板口をケーブル切を介して接地することにより、 シールド板口にシールド効果を発揮させている。

シールド板切は、導電性部材で形成されている。 このようにして測定された測定結果に基づいて 半導体チップの良品と不良品を特定する。

また、被認定体を構成する半導体チップが例えばパワートランジスタである場合、 教図台のは、 次のように構成されていた。 即ち、第8 図に示す如く、アルミニウム台(2b)の表面には、例えば全でからなる円形の電圧制定電極のの開閉には、 例えば金メッキ等からなる環状の電圧印加電極のが形成されている。電圧測定電極のと電圧印加電極のの間には、 所定の間隔が設けられている。この間隔によって、 電圧測定電極のと電圧印加電極のは、 性気的に絶縁されている。

また、第10回に示す他の例のものでは、アルミニウム台(2b)の設面に、例えば金メッキ等からなる半円形の住圧測定電極向と電圧印加電板(10)とが所定の問題を設けて、互いに電気的に絶縁された状態で形成されている。

このように構成された第9回、第10回の電気特

- 3 -

うず電流を発生させる。このうず電流の影響により、 報電台図上の半導体ウェハ(U)の裏面の電位が 0 ボルトにならない。その結果、半導体チップの 電気特性の測定に誤差が発生する問題があった。

又、第9回、第10回で示したような教習台の標成では、半導体ウエハに形成された半導体チップの位配に形成された半導体チップの位配にの切に対する距離が異なる。一方、半半所体では、不変を表して、電圧のの変面に形成されたコレクタ電低は、所定の電気がある。従って、電圧の間に形成では、各々の半導体チップの電気特性測定時に生じている。といるでは、半導体ウェハ上の半導体チップの位置に相違が生じる問題があった、遺産対象に相違が生じる問題があった。

この発明は上記点に対処してなされたもので、 観聞台内で発生するうず電流を防止し、被測定体 の世気特性を例めて正確に測定することができ、 又、被測定体のどの位置においても、電気特性を 極めて正確に測定することができる電気特性制定 性測定装置では、次のようにして半導体ウェハの 良否を判定する。

すなわち、パワートランジスタ等からなる半導体チップを形成した半導体ウェハをアルミニウム台(2b)上に被関する。次いで、電圧印加電極的(10)から半導体ウェハの裏面に形成されたコレクタ電便に所定の電圧を印加する。次いで、半導体ランプの良否を関べる。この結果、半連体ウェハの良否を判定する。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上述したような第8図で示した電気特性測定装履では、截配台20の一部がアルミニウム台(2b)で形成されている。アルミニウムは、導電性の材料である。このため、電気特性制定数置に附属されたモータ等の附属計器からのノイズが、電磁誘導作用によりアルミニウム台(2b)内に

- 4 -

装置を提供するものである。

(発明の構成)

(課題を解決するための手段)

本発明は、被測定体を導電性酵板を介して報配 台に報配し、この被測定体の電気的特性を測定す る装置において、上記載置台を組縁体により構成 することを特徴とする電気特性測定装置を得るも のである。

(作用)

本発明の電気特性測定装置では、載置台を絡録体で形成している。このため、測定時にノイズによる電磁誘導作用によって、載配台内にうず電流が発生するのを防止することができる。その結果、1フェムト・アンペア(1×10⁻¹³アンペア)レベルの微小電流によって被測定体の電気特性を傾めて正確に測定することができる。

また、戦闘台の絶縁抵抗値が大きいので、大電 流による測定時に被測定体と製置台下部の接地部 間で放電が起きるのを防止することができる。そ の結果、従来の装置に比べて約50倍以上の大電法 による電気特性の測定を高い精度で行うことがで きる。

また、本発明の電気特性脚定装置の導体部に、 細い筋状の絶縁領域によって分割された電圧印加 電極と壁圧測定電極を形成しても良い。

このような構成により、被測定体の下部に必ず電圧印加電便と電圧測定電極を配置することができる。その結果、被測定体の下部側の電極部で起きる電圧降下によって、測定値が変化するのを防止することができる。これにより、被測定体の電気特性を傾めて高い特度で測定することができる。(実施例)

以下、本発明電気特性測定装置の一実施例を図面を参照して説明する。

第1図は、本発明の一実施例の電気特性限定装置の概略構成を示す説明図である。図中(20)は、 裁配台である。 載版台(20)上には、半導体ウェハ (21)等の被測定体が載図されるようになっている。 裁盟台(20)には、上面のウェハ載電面から底部の 裏面側に貫通する真空口(22)が形成されている。

- 7 -

(25)は、例えば銀パラジウムで形成されている。 上部(20a)を下部(20b)に固定する方法は、例え ば複数個のポルトネジ(27)によって行われる。し かし、石英からなる上部(20a) には、ネジ山を切 ることができない。このため、上部(20a) の周線 部の所定箇所(例えば8箇所)に垂直方向に沿っ て貫通穴(28)を開口する。これらの貫通穴(28)に 対応する下部(20b) の位置に金属製雌ネジブッシ ュ(29)を埋設する。この金属製造ネジブッシュ (29)に、例えばゴム製 O リング(30) 等からなる弾 性部材を介して、貧通穴(28)にポルトネジ(27)を 排入する。ポルトネジ(27)を金属製雌ネジブッシ ュ(29)に煤合し、上部(20a)と下部(20b)を一体に **固定した戦闘台(20)を得る。ゴム製〇リング(30)** 等を使用するのは、ボルトネジ(27)を金属製造ネ ジブッシュ(29)に強く締め付けた際に、石英から なる上部(20a) が破損するのを防止するためであ

支持台(23)は、例えばセラミックスで形成されている。支持台(23)は、図示しない駆動モータに

報置台(20)は、支持台(23)上に設置されている。 其空口(22)は、支持台(23)に形成された中空部 (24)に連通している。中空部(24)は、吸引管(25) を介して例えば真空ポンプ(図示せず)のような 吸引器に接続されている。報置台(20)上に報置される半導体ウエハ(21)は、真空口(22)等で構成される吸引機構によって、報配台(20)上に吸着固定 されるようになっている。

戦響台(20)は、上部(20a)と下部(20b)の2層標準になっている。上部(20a)は、例えば石英などからなる絶験体で構成されている。上部(20a)の要面は、ウエハ戦間面になっている。ウエハ戦間面は、皮触抵抗質が低い遊電性確板からなる過速体部(25)で形成されている。導体部(25)は、例えばを金のメッキ。蒸着或いはスパッタリングにより形成されている。であることができる。下部(20b)は、例えばを予ミックスのような絶縁体で構成されている。が一ド電極(26)が形成されている。ガード電極(26)が形成されている。ガード電極(20b)に電気を極いる。ガード電極(26)が形成されたいる。ガード電極(26)は、級配台(20)に電気を

- 8 -

よって、上下(Z), 左右(X), 前後(Y) 方向に自在に移動可能になっている。

支持台(23)の底面には、シールド部材(31)が贴着されている。シールド部材(31)は、例えば金、銀パラジウムのような導電性の高い材料で形成されている。シールド部材(31)は、例えばケーブル(32)を介して装置箆体(図示せず)に接続され接地されている。シールド部材(31)を設けた理由は、駆動モータ等のノイズによって被酬定体の半導体ウェハ(21)の賃気特性の測定に感影響が起きるのを助止するためである。

支持台(23)と載度台(20)は、例えば次のようにして固定されている。すなわち、例えば、支持台(23)の周縁部の所定箇所(例えば4箇所)に、垂直方向に沿って貫通穴(33)を閉口する。これらの頁通穴(33)に対応する戦置台(20)の部分に、ガード電極(26)を貫装して例えば金属製雌ネジブッシュ(34)を埋設する。貫通穴(33)を介して金属製雌ネジブッシュ(34)に、下方からボルトネジ(35)を螺合する。これによって、支持台(23)と載製台

(20)とを一体に固定する。

級試台(20)の上方には、半導体ウエハ(21)に形成された半導体チップの電気的特性を測定するためのプローブカード(36)が設けられている。プローブカード(36)には、半導体チップの所定のパッドに当接するプローブ針(37)が突設されている。

このように構成された電気特性測定装置は、次のようにして例えば半導体ウェハ(21)に形成された半導体チップの電気特性を測定する。

先ず、図示しない搬送機構の例えばハンドアームにより、半導体ウエハ(21)を載置台(20)上の所定位置に搬送する。

次いで、測定しようとする特定の半導体チップが、プローブカード(36)のプローブ針(37)の直下に位置するように、戦闘台(20)を支持台(23)と一体にして、駆動モータ(例示せず)により、所定距離だけ前後(X)、左右(Y)方向に移動させる。訓定しようとする半導体チップをプローブ針(37)の直下に位置付けた状態で、報覧台(20)をプローブカード(36)に向けて上昇(2万向)させる。この

- 11 -

この微小電流の変化状態から、半導体チップの電気的特性を測定する。この場合、ガード電極(26)は、シールド部材(31)の影響を受けずに、2項に電気的にシールドされる。その理由は、ガード電極(26)が測定器(39)のグランド部に接続されており、かつ、シールド部材(31)が接地された装置筐体に接続しているからである。この2重シールドによって、1フェムト・アンペア程度の微小電流を、ノイズ等の影響を受けずに電気特性測定用の電流として使用することができる。

また、御定器(39)と導体部(25)を介して行う半導体ウエハ(21)との電気的接続は、第3図(A)に示す如く、測定器(38)の入力側の内部抵抗等の影響を少なくした、グランデッド接続や、第3図(B)に示すようなフローティング接続のような所謂アース接続によって速成できる。このような接続によって、測定器(39)と半導体ウエハ(21)を接続することにより、調定器意を小さくすることができる。

このようにして半導体チップが所定の電気特性

換作により、プローブ針(37)と半導体チップの所 定部分とを、電気的に接触させる。

この接触状態から被置句(20)を更に例えば10~200m 上昇させてオーバードライブをかける。この状態で半導体チップの電気物性の測定を行う。

次いで、第2回に示す如く、半導体ウエハ(21)の裏面と接触している導体部(25)に開軸ケーブル(38)の芯線を接続する。開軸ケーブル(38)の他端側は、認定器(39)に接続されている。開軸ケーブル(38)のシールド部は、ガード電極(26)に接続する。つまり、半導体ウエハ(21)の裏面側は、導体部(25)。同軸ケーブル(38)を順次介して、認定器(39)のグランド部に接続される。なお、支持台(23)は、シールド部材(31)を介して装置で体のグランド部に、前述したように接続されている。

この状態で、プローブ針(37)或いは専体部(25)から測定用の微小電流を、半導体チップの所定部分に流す。微小電流としては、例えば1フェムト・アンペア (1×10-11アンペア)程度の電流を使用する。

- 12 -

を個えているか否かを微小電流の変化から測定する。1つの半導体チップの電気的特性を測定した後、軟配台(20)を支持台(23)と一体に降下する。次いで、前述と同様に次に測定すると呼びないがプローブ針(37)を収集を多動させる。次の所定部分に接触させる。その半導体チップの所定部分に接触させる。そりで、がでの変化から、この半導体チップの所定部の変化がら、この半導体チップの所定ので、でので変化がある。以下、関係の関係を観えているか否かを測定する。以下、同様の操作を繰返し、半導体ウエハ(21)に応されらの測定データから半導体ウエハ(21)の良否を測定する。

このような微小電流を用いた半導体チップの電気的特性の測定においても、 敷置台(20)が石英からなる上部(20a)とセラミックスからなる下部(20b)で構成され、大きな電気的絶縁抵抗を有しているので、 載置台(20)内部で周囲のモータや外部等からのノイズの影響を防ぐことができる。そ

の結果、ノイズに起因するうず電流の発生を防止 して、半導体チップの電気的特性の測定精度を向 上させることができる。

また、大電流を用いて半導体チップの電気的特性を測定する場合は、プローブ針(37)から半導体チップに例えば5アンペアの電流或いは例えば2500ポルトの電圧を印加する。

この場合も、上述と同様に載置台(20)が、大きな電気的絶縁抵抗を備えた絶縁体を構成しているので、極めて高い耐圧特性を示す。その結果、シールド部材(31)と大電圧(2500 V)を印加した半導体ウエハ(21)間の放電を防止することができる。これにより、極めて高い精度で半導体チップの電気的特性を測定することができる。

このように、戦国台(20)を絶縁抵抗の大きいものとすることにより、ノイズの電磁誘導作用によるうず電流の発生を防止できる。もって、半導体ウエハ(21)等の被例定体の電気特性を、1フェムト・アンペア(1×10⁻¹)程度の微小電流で高符度に行うことができる。従来の装置では、1ピコ・

- 15 -

及び電圧印加電極(42)とで構成されている。

電圧測定電瓶(41)は、載置台(20)のほぼ中心を 通る仮想の直線(L₁)上の両婚部に、2個の測定電 極接続端子(41a)を有している。

電圧印加電極(42)は、数量台(20)のほぼ中心を 通る仮想の直線(L_x)であって、前途の直線(L_x)と 直交する直線(L_x)の間端部に、2個の印加電極接 統築子(42a)を有している。

電圧測定電極(41)と電圧印加電極(42)は、導体部(40)の扱而を細い筋状の蛇行した絶縁領域(43a)(43b)で分割することにより構成されている。すなわち、まず、例えば上記仮想の直線(L.)で分割された半円形の単体部(40)の部分に、上記他の仮想の直線(L.)を対象軸にして、細い筋状の蛇行した絶縁領域(43a)を形成する。この絶縁領域(43a)を境にして分けられた内側の導体部(40)が、電圧測定電極(41)の半分を形成する。この絶縁領域(43a)を境にして分けられた外側の導体部(40)が、電圧可定電極(41)の半分を構成する。更に、上記仮想の直線(L.)を対象軸にして、ほぼ阿禄の絶数

アンペア (1 ×10⁻¹¹ アンペア)程度の微小電流しか使用できなかった。

また、叙置台(20)の純緑抵抗値が大きいので、 西定時に被測定体と載置台(20)下面の接地部間で、 放電が起きるのを防止できる。その結果、従来の 装置に比べて、50倍以上も大きな大電流による被 測定体の電気的特性の測定を、高い精度で行うこ とができる。

また、被調定体の半導体ウエハ(21)に例えばパワートランジスタ等からなる半導体チップが形成されている場合に、選体部(25)を第4図に示すような構成にすることにより、高い精度でかかる被測定体の電気的特性を測定することができる。なお、導体部(25)以外の部分の構成は、上述の第1図に示したものを採用することができる。

この選体部(40)は、例えば金等の材料で形成されている。この導体部(40)は、電圧測定電極(41)

- 16 -

領域(43b) を残る半円形の導体部(40)に形成する。 この絶縁領域(43b) の内側の導体部(40)に、残る 電圧測定電極(41)が形成される。この絶縁領域 (43b) の外側の導体部に、残る電圧印加電極(42) が形成される。

つまり、遊体部(40)の全体について、例えば、一方の部定電極端子(41a) 側から、他方の測定電極端子(41a) 側に亘ってながめると、絶象領域(43a)(43b)を現にして、電圧測定電極(41)と電圧印加電極(42)が、絶級領域(43a)(43b)によって電気的に絶縁された状態で、交互に形成されていることになる。

なお、このような事体部(40)の場合、図示しないが、第1回の真空口(22)に相当するものは、多数例の群、改は細孔の形で導体部(40)に設けられている。このように構成された事体部(40)上にパワートランジスタ等からなる半事体チップを多数個形成した半導体ウエハ(21)を固定する。

次いで、電圧印加電極(42)から半導体ウェハ (21)の裏面のコレクタ電腦に所定の電圧を印加す る。この電圧を電圧測定電極(41)によって測定する。この場合、半導体ウェハ(21)の表面側に形成された電極、例えばエミッタ電極、ベース電極等には、プローブ針(37)が当接されている。

このようにして、半導体チップの電気的特性を 測定する。この測定データに基づいて半導体ウェ ハの良否を判定する。このようにして電気的特性 を測定すると、絶数領域(43e)(43b)によって分離 され、かつ、交互に配置された電圧測定電極(41) 及び電圧印加電極(42)が、測定時に半導体ウェハ (20)の裏面に接触していることになる。

この結果、半導体ウエハ(21)の裏面の電極の位置の違いによって生じる電圧降下が、夫々の半導体チップの電気的特性の測定の際に駆影響を及ぼすのを排除することができる。

また、この例において、上記実施例の効果も併せて享有できることは勿論である。

さらに、他の実施例について説明する。

まず、被測定体例えば半導体ウェハの電気特性 の測定に使用するウェハブローバについて無 7 回

- 19 -

プローブ針(50)が取着されている。

尚、上記測定部(48)の上方にはスコープ(58)が 設けられている。このスコープ(58)はICチップ (56)の電優パッド(57)とプローブ針(50)の先始の 位置合わせを目視観察するものである。上記のよ うにウエハブローバ(45)が構成されている。

ここで、このウェハプローバ(45)には、駆動部やコントローラ部等が設けられているので、この駆動部等からノイズが発生する。このノイズは、テスタ(51)からの測定信号に悪影響を与える。即ち、測定信号は、高層波の微小電流なので、上記ノイズが重畳すると、正確な測定ができなくなる。この対策として、上記載置台(52)は、次に示すように構成されている。

第5図のように、導電性の材質例えばA2製の栽園台(52)のウエハ穀図面に、絶縁部(59)が形成されている。これは、例えばシュー酸アルマイト処理により、A2,0。を形成したものである。ここで、この絶縁部(59)の厚さは例えば50~150μm であり、実験の結果、栽図台(52)が直径135 xm × 厚さ10 xm

を参照して説明する。

上記ウエハブローバ(45)は大別してウエハカセット(46)からウエハ(47)を認定部(48)まで販送するローダ部(48)と、上記ウエハ(47)にプローブ針(50)を接触して、ウエハテスタ(51)と導通させて記定する測定部(48)とから構成されている。上部測定部(48)には、半導体ウエハ(47)を報配する報配台(52)が移動可能に設けられている。この報配台(52)は、駆動部(53)に係合して設けられている。この駆動部(53)により報置台(52)は、平面方向(メ Y 軸方向)、上下方向(2軸方向)及び周方向(8方向)に移動できる。

このような親質台(52)に、ウエハ(47)を搬送するために、ローダ部(49)に回転アーム(54)が設けられている。

又、報復台(52)の移動範囲内の所定の位置において、その上方に対向するように、プローブカード(55)が設置されている。このプローブカード(55)には、半導体ウエハ(47)に形成されたICチップ(56)に配列された電極パッド(57)に対応して、

- 20 -

の場合、適正額が60mとわかった。又、報理台 (52)と駆動部(53)との係合において、係合位置に 総縁材質例えばセラミック製のチャンパ(60)が設けられている。このことにより、報復台(52)と駆動部(53)とが絶縁されている。又、報置台(52)は、グランド線(61)により電気的に接地されている。このグランド線(61)は、報理台(52)が移動するので、このことに対応してスパイラル形状としている。

上記のような戦闘台(52)に、ウエハ(47)を戦闘するとウエハ(47)は絶縁部(59)により、世気的にフローティング状態となる。

次に上記したウエハプローバ(45)による半導体 ウエハ(47)の電気特性の御定動作を説明する。

まず、ウエハカセット(46)から所定のウエハ(47)をローダ部(48)から取出す。このウエハ(47)を、プリアライメント後、回転アーム(54)により 数置台(54)上に 殺闘する。そして、 図示しないアライメント部でアライメント後、 穀糧台(52)を移動することにより、ウエハ(47)をプローブカード

(55)下方向に設ける。ここで、第6図のように戦 置台(52)を上昇することにより、ICチップ(56)の電極パッド(57)にプローブ針(50)を接触させる。この接触状態でテスタ(51)から謝定信号を、印加する。即ち、ICチップ(56)の入力電極(57)に測定信号を印加し、出力電極(57)に発生する電気的信号をテスタ(51)で測定する。この測定は、上記電極(57)間の電圧(V)及び電流(A)を測定する。そして、この測定した値から、例えば容量値を算出して、ICチップ(56)の良・否を判別する。

上述したような測定に関し、駆動部等から発生 するノイズや外部からのノイズは次のようにして アースされている。

発生したノイズは、穀配台(52)の導電部に重昼する。この重昼したノイズは、グランド線(61)によりアースされる。ここで、穀置台(52)のウエハ穀置面は、絶縁部(59)で形成されている。穀置されたウエハ(47)は、電気的にフローティング状態となる。つまり、ウエハ(47)には、穀配台(52)の楽電部に重昼したノイズが流れることはない。又、

- 23 -

部材より耐久性に優れている。

以上説明したようにこの実施例によれば、導電性親配台の被測定体の裁置面に絶縁部を形成し、 親関台の導電部を電気的に接地したことにより、 駆動部等から発生するノイズは被測定体に悪影響 をおよぼすことなく、上記載電台の導電部からグ ランドに落とされ、測定信号にノイズが重量する ことなく正確な測定が行なえる。

(発明の効果)

本発明の電気特性測定装置は、被測定体の戦置台を絶縁体で形成している。このため、測定時にノイズによる電磁誘導作用によって、戦闘台にうず電流が発生するのを防止することができる。この結果、極めて微小な電流によって被測定体の電気特性を高い精度で測定することができる。

また、報覧台の絶縁抵抗値が大きいので、大電流による例定時に、被調定体と接地部間で放電が起きるのを防止することができる。この結果、従来の装置に比べて約50倍以上の大電流による電気特性の測定を高い特度で行うことができるもので

実験の結果、ICチップ(56)に微小電流を迸して も、リーク電流はほとんど検出されず正確な測定 が行なえた。

上記実施例では、表面即ち戦配面をシュー酸アルマイト処理した導電性戦闘台について説明したが、これに限定するものではなく上記導電性戦闘台上面にセラミック部材をプラズマ溶射して、平坦に固着したものでも良い。

上記セラミック部材をプラズマ審射した導電性 報置台にあっては、同様に微小電流をウェハチップに洗しても、測定に影響することはなく、許容 登内で測定が可能である。

又、上記導電性報酬台上面にテフロン (商品名) をコーディングした戦闘台にあっては、上述した 微小電流に近い状態の測定が可能である。

又、このテフロンコーティングされた遊電性収 置台を用いると、誤ってテフロンコーティング表 面に、マーキング用のレーザを風射しても、テフ ロンは熱伝導率が高いので、脱射された熱が早速 に熱拡散する。このため従来の金属例えばアルミ

- 21 -

ある.

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例の電気特性測定装置 の概略構成を示す説明図、第2図は第1図に示し た装置に測定器を接続した状態を示す説明図、第 3 図(A) は第1 図においてグランデッド接続によ り、脚定冊と半導体ウェハを接続した状態を示す 説明四、第3回(B) は第1回においてフローティ ング接続により測定器と半導体ウエハを接続した 状態を示す説明図、第4 図は第1 図装置の所定形 状の電圧測定電優と電圧印加電極で構成された導 体部を示す平面図、第5図は第1図の他の実施例 を説明するための装置構成説明図、第6図は第5 図の親庭部構造を説明するための説明図、第7図 は第5回装置をウエハプローバに用いた例を説明 するための図、第8図は従来の電気特性測定装置 の概略構成を示す説明図、第9図は第8図の電気 特性別定装置の戦闘台の一例の表面を示す平面図、 第10回は第9回の戦闘台の表面の他の例を示す平 面図である。

20 … 戦 盟 台

20a…上部

206…下部

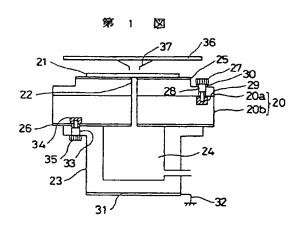
21…半導体ウエハ

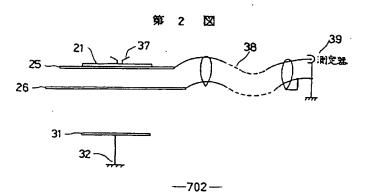
36…プローブカード

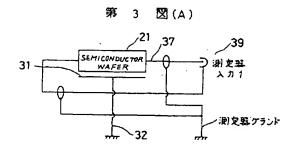
37…プローブ針

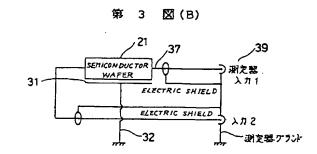
特許出顧人 東京エレクトロン株式会社

- 27 -

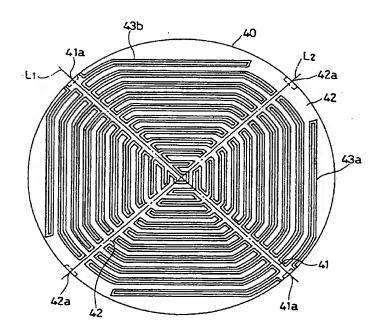


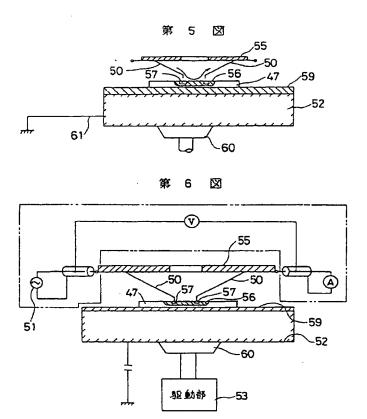


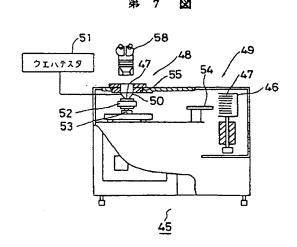




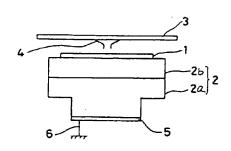
第 4 図







第 8



手続補正書(自発)

1. 事件の表示

特願昭63-153742号

2. 発明の名称

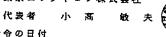
電気特性測定装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 〒163 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

名称 東京エレクトロン株式会社

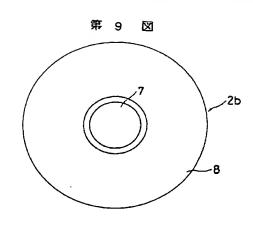


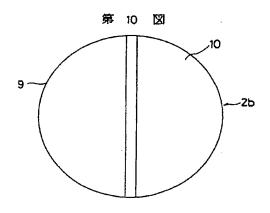
4. 補正命令の日付

自発

- 5. 補正の対象
- 6. 補正の内容
 - (1) 明細書の特許請求の範囲を別紙のとおり訂正する。 (2) 明細書第5頁3行目「Uボルトにならない。」を 「大きい。」と訂正する。







(別 紙)

- 2. 特許請求の範囲
 - ① 被測定体を導電性薄板を介して載置台に載置し、 この被測定体の電気的特性を測定する装置におい て、上記載置台を絶縁体により構成することを特 徴とする電気特性測定装置。
- (2) 導質性薄板には、被測定体に質圧を印加する質 圧印加電極と電圧を測定する電圧測定電極とが筋 状の絶縁領域によって交互に形成されていること を特徴とする鏡求項」記載の電気特性測定装置。